



新聞聯絡人：台灣應用材料 李健宇

聯絡電話：03-579-3775

e-mail：Debbie_Lee@amat.com

發稿日期：民國 115 年 8 月 18 日

應用材料公司於 SEMICON Taiwan 聚焦未來半導體關鍵技術 材料創新驅動 AI 運算突破



隨著 AI 帶動運算需求快速成長，半導體產業正邁向 3D 結構與系統級整合的新階段，創新模式也從單點技術突破，轉向材料、製程、設備與封裝的協同優化。材料工程作為提升效能、優化功耗與加速量產的基礎，其重要性日益凸顯。應用材料公司將於 SEMICON Taiwan 2026 引領多場技術論壇，聚焦先進製程、異質整合、面板級封裝與智慧製造等關鍵議題，分享驅動高效、節能 AI 運算的創新成果。

應用材料公司集團副總裁暨台灣應材總裁余定陸表示：「AI 正推升半導體創新的複雜度，任何突破都仰賴生態系的共同創新。深耕台灣 36 年來，應材始終是台灣世界級半導體生態系發展的重要推手。我們透過與客戶、夥伴及供應鏈的緊密合作，結合寬廣且互連產品組合及材料工程專長，加速研發成果導入量產。期待促進產業交流與對話，匯聚創新能量，共同推動新一代技術。」

聚焦產業關鍵議題，應材專家共話 AI 時代創新方向

在異質整合國際高峰論壇中，資深技術處長藍章益將擔任論壇主席，以「AI Packaging Supply Chain Ecosystem & Driving Technology」為主軸，引領產業專家共同探討 AI 時代下先進封裝供應鏈的發展趨勢及驅動技術。客戶技術處長 Michael Rosshirt 亦將分享應材的面板級封裝（Panel-Level Packaging, PLP）產品組合，包含面板級電化學沉積（Electrochemical Deposition, ECD）等技術，如何協助產業在更大尺寸面板平台上實現先進封裝製造。

資深處長 Ashok Kumar Muthukumaran 將於半導體先進製程科技論壇，剖析細間距混合鍵合與裸晶對晶圓（Die-to-Wafer, D2W）整合創新，如何透過更高的互連密度、更低的功耗及可擴展的異質整合，突破 AI 能源瓶頸。在面板級扇外型封裝創新論壇中，應材數位微影事業群總經理 Anant Chimmalgi 則將進一步說明數位微影技術如何結合無光罩曝光與數位動態連結功能，即時校正曝光偏差，提升大尺寸面板的圖案化精度與製程良率。

此外，自動化產品事業群策略行銷資深經理 Mingyuan Zhao 將於高科技智慧製造論壇，探討如何運用代理式 AI 加速晶圓廠從自動化邁向自主化營運，並以半導體製造現場的實際挑戰為例，展示 AI 驅動系統如何即時偵測異常、進行根因分析，支援更快速且精準的決策，進而提升良率、生產力與營運韌性。

更多應用材料公司 SEMICON Taiwan 2026 論壇資訊（8 月 31 日至 9 月 4 日），敬請造訪：
<https://appliedmaterials.com/semicon-taiwan-2026>

應用材料公司（那斯達克代號：AMAT）是材料工程解決方案的領導者，其技術深植於全球幾近所有新世代半導體與先進顯示器的核心，並在推動人工智慧技術發展與加速次世代晶片商業化扮演關鍵角色。在應用材料公司，我們突破科學與工程的極限，引領材料創新，驅動世界的關鍵變革。瞭解更多訊息，請至 www.appliedmaterials.com